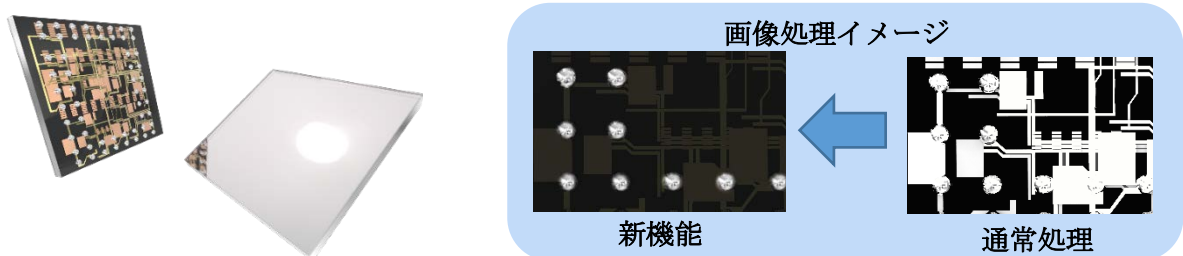


小型化・高性能化が進むモジュール部品メーカー向けの FUJI 実装ソリューション

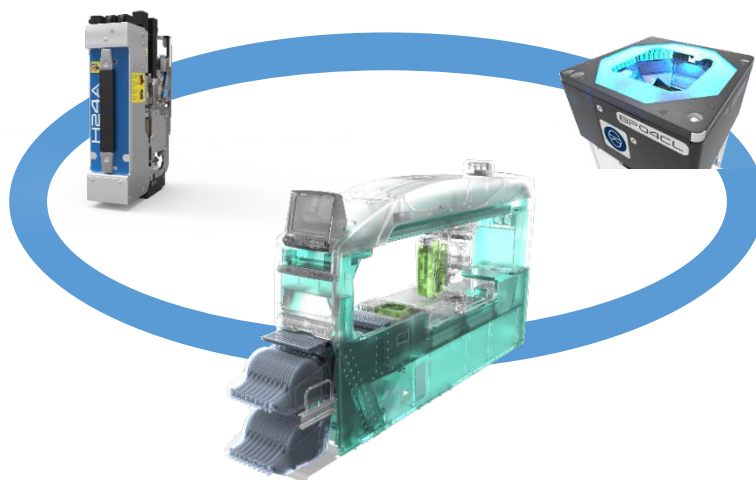
株式会社 FUJI（本社：愛知県知立市、代表取締役社長：曾我 信之）が、新たに開発しました機能についてご紹介致します。

モバイル機器、ウェアラブル機器の普及とともに、これらに使用されるモジュール部品の需要が増加しています。これに伴い、ますます小型化・軽量化と高性能化が進み、モジュール部品を構成する部品も小型化、高性能化が進んでいます。

生産現場では、新しい部品に対応し、効率よく生産する必要が出ていますが、解決すべき問題もあります。例えば、システムインパッケージ（SiP）やウエハレベルチップサイズパッケージ（WLCSP）などは、部品を実装する場合、画像処理においてパンプの位置が正確に検出できないという問題が発生していました。



FUJI は画像処理カメラの機能向上により、SiP や WLCSP などの回路からパンプ部品のみを撮像する技術に成功しました。更に、実装モジュール（M3IIIS）、ヘッド（H24A）、ディッピングユニット、特殊ノズル（スリット付きノズル）、バキュームバックアップなど、モジュール部品製造に有効なユニットや機能の組み合わせを提案することで、モジュール部品の高品位実装が実現し、生産効率アップにつながります。



製品に関する詳細な情報は、営業までお問い合わせ下さい。